

SB6N58-HF350 / SB6NX58-HF350 (Sn 3.5Ag 0.5Bi 6.0In / Sn 3.5Ag 0.5Bi 6.0In 0.8Cu) Type 4

## 高耐久はんだ合金ソルダーペースト (In系)

優れた耐冷熱サイクル性、IPC J-STD-004B規格でROLO

- 高信頼性ハロゲンフリー製品で、大気リフローに対応
- IPC J-STD-004B 規格で ROLO
- 0603 チップでの確実な実装特性を確保



高耐久合金

ハロゲンフリー

SB6N58-N300 (Sn 3.5Ag 0.5Bi 6.0In) Type 4

## 高耐久はんだ合金ソルダーペースト (In系・残渣割れ防止)

耐冷熱サイクル性 + 耐残渣クラック = 高信頼性

- 冷熱サイクルによるクラック進行を抑え、接合強度の低下を抑制
- クラック発生を防ぐ合金組成で、優れた接合信頼性を維持
- 過酷な冷熱サイクル条件 (-40°C~+125°C、3000 サイクル) でもリード間を連結する残渣クラック発生無し



初期

3000サイクル後  
冷熱サイクル条件  
-40°C~+125°C

高耐久合金

残渣クラックレス

N<sub>2</sub>リフロー用

S1XBIG58-HF1100-3 / S01XBIG58-HF1100-3 (Sn 1.1Ag 0.7Cu 1.8Bi + Ni / Sn 0.1Ag 0.7Cu 1.6Bi + Ni) Type 4

## 低コスト・耐久性向上はんだ合金ソルダーペースト (汎用・車載対応多機能)

SAC305と同等以上の接合信頼性を実現

- SAC305 と同じリフロープロファイルにてリフロー可能
- Bi と Ni 添加によるハイブリッド強化で、経時的な組織変化を抑制
- モバイル機器からカーオーディオ等まで、幅広い用途に対応可能



S1XBIG合金

SAC305

冷熱サイクル後のはんだ接合部  
(-40/+125°C x 2000cycles)

低Ag合金

高濡れ

ハロゲンフリー

S1XBIG58-M650-7 (Sn 1.1Ag 0.7Cu 1.8Bi + Ni) Type 4

## 低コスト・耐久性向上はんだ合金ソルダーペースト (ピンコンタクト・洗浄対応)

SAC305リフロープロファイル対応

- Bi と Ni 添加によるハイブリッド強化で、経時的な組織変化を抑制
- ICT に対応、ピンへのフラックス残渣付着を防止
- SAC305 と同等以上の接合信頼性を実現



ICTチェッカープローブ写真

S1XBIG58-M650-7

従来品

低Ag合金

ハロゲンフリー

ICT対応

洗浄可能